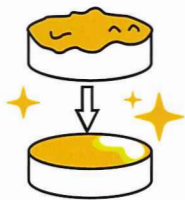


100ナノの超精密

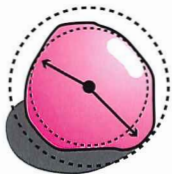
TDCは超精密鏡面加工技術を応用して、
各種の加工仕様を実現します。



面粗さ: Ra 1nm



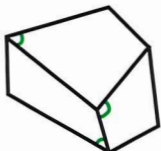
平面度: 30nm



真球度: 50nm



平行度: 100nm



角度: ±3秒



寸法公差: 100nm

鏡面研磨技術の超精密化により、各種の要素において高精度なものづくりが可能となりました。面粗さ、平面度・平行度、寸法管理、角度管理、など各種の加工仕様において極限の精度が実現可能です。

金属、セラミックス、ガラス、半導体、新素材などあらゆる材質に対応。

平面のみならず、曲面・球面にも対応。

これらの加工精度は他社の追随を許しておらず、国内外問わず**オンリーワン**です。TDCの加工技術は半導体製造装置や精密機器の研究開発、高精度化に不可欠な要素技術です。

各種機械加工、ラップ、研磨の各種加工を組み合わせ、お客様のご要望に総合的なソリューションを提供いたします。

※加工事例については、裏面をご覧ください。

<ランチョンセミナーのご案内>

「超精密な鏡面加工技術のご紹介」

日時; 12月5日(水) 12:35~13:20

会場; D会場(コンベンションセンター1階・研修室)

受付; 大会受付(当日9:00~)

株式会社ティ・ディ・シー

ホームページ: <http://www.mirror-polish.com> Eメール: tdc@mirror-polish.com